



化合物半导体中试平台

湖北九峰山实验室

材料验证报告

产品名称: 无氰亚硫酸盐镀金液

厂家名称: 深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司

型号规格: AURIFAB SC-1030

批准人: 

审核人: 

编制人: 

发布日期: 2026年07月15日



地址: 湖北省武汉市东湖高新技术开发区九龙湖街9号

网址: www.jfslab.com.cn

邮箱: yzpt@jfslab.com.cn





免责声明

1. 本报告是在特定验证环境、条件及方法下,对报告所述特定产品(下称“验证产品”)进行验证后形成的客观数据记录与分析。报告内容仅反映验证产品在验证期间的实际表现,不构成对验证产品性能、质量、安全性、可靠性、合规性或其满足任何特定标准、技术规范、法律法规、市场准入要求或商业目的的任何形式的担保、保证、认证或承诺。
2. 本报告仅对验证产品个体有效,不代表生产厂家同型号批量产品的整体性能,不对产品原材料、生产工艺、出厂质量、长期使用可靠性作出整体性判定。
3. 本报告仅用于技术评估与参考。任何单位、个人不得将报告或其任何部分用于:
 - (1)作为证明验证产品符合任何法律法规、标准或第三方要求的官方认证文件;
 - (2)产品广告、宣传资料或投标文件中的承诺性内容;
 - (3)任何可能引致第三方依赖并据此作出商业、投资或法律决策的依据。
4. 任何单位、个人依据本报告内容作出的任何决策或行为,均由其自行承担全部风险与责任,本实验室不承担任何责任。
5. 本报告内容不得单独拆解使用。对报告内容的部分复制、私自转让、冒用、篡改,均属无效,九峰山实验室将追究上述行为的法律责任。



验证报告

一、基本信息			
产品名称	无氰亚硫酸盐镀金液	型号规格	AURIFAB SC-1030
厂家名称	深圳市联合蓝海应用材料科技股份有限公司	生产日期	2026 年 03 月
验证地点	湖北九峰山实验室	验证周期	2026 年 03 月至 2026 年 05 月
产品功能介绍	AURIFAB SC-1030 无氰亚硫酸盐镀金液采用无氰高金体系，搭配 CLASSONE 水平电镀机台，可满足厚金电镀与 BSV 通孔填充电镀生产需求。		

二、验证结果					
序号	类别	验证项目	技术要求	厂家设计值	验证实测值
1	组分浓度参数	Au 离子, g/L	12~18	12~18	15
2		亚硫酸根, g/L	55~65	55~65	58
3		波美度 (25℃), ° Bé	7~27	7~27	16.8
4		PH (25℃)	8~9	8~9	8.6
5	工艺性能验证	电镀高度, μm	3~40	3~40	2.8~41.1
6		均一性 ($\frac{MAX-MIN}{2 \cdot AVG}$ %), %	≤5	≤5	2.5
7		镀层粗糙度 Ra, nm	≤50	≤50	15
8		PR 变形量, μm	≤2	≤2	1.2
9		BSV 背孔填充率, %	≥50	≥50	67

三、指导参考	
本次验证的 AURIFAB SC-1030 无氰亚硫酸盐镀金液采用无氰高金体系，验证期间(2026/03-2026/05)内，搭配 CLASSONE 水平电镀机台，可以满足厚金(3~40 μm)电镀和 BSV 通孔填充电镀工艺需求。厚金电镀和 BSV 填通孔表现均达到预期设计目标。药液在生命周期和可靠性方面的表现待进一步验证。	



四、验证小组人员

序号	姓名	角色	签名
1	廖	验证技术专家	廖
2	李	验证技术专家	李
3	罗	工艺工程师	罗
4	吴	设备工程师	吴

报告结束